

特

集

半導体の未来がここにある。

SEMICON JAPAN 2024

2024年12月11日(水)～13日(金) 東京ビッグサイト

DX時代を支え、先端技術の核である半導体は現代の最先端アプリケーションにコア技術として組み込まれているだけでなく、身近な電子部品や、すでに当たり前となったPCやスマートフォンなどの製品にも欠かせない要素となっている。

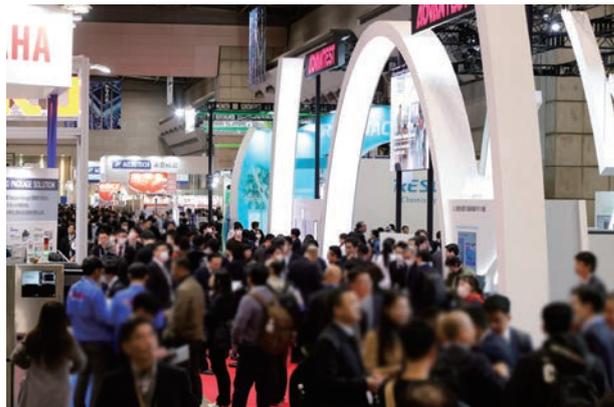
こうした中、半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのSMARTアプリケーションまでカバーするエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会「SEMICON JAPAN 2024」(主催：SEMIジャパン)が2024年12月11日(水)～13日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催される。

■「未来」を感じる、多彩な企画展示

同展にはAI、5G/6G通信技術、自動車(EV、自動運転)などの先端半導体および将来アプリケーション、マスクやウェーハ等の製造用装置、半導体製造用部品・材料、各種サービス・ソフトウェアなどそれぞれの分野の企業や団体、や大学・官公庁などが出展しており、デバイスメーカーやOSATの技術者、システムメーカー、経営者・投資家、営業・マーケティング担当者、若手エンジニア、学生など多様な目的の来場者を見込んでいる。また半導体パッケージング、基板実装分野のトッププレイヤーが集

結する「APCS (Advanced Packaging and Chiplet Summit)」や初開催となる半導体業界の設計分野に特化した新しいサミット「ADIS (Advanced Design Innovation Summit)」などの多彩な企画展示が同時開催される。

国内外からエレクトロニクスに関する最先端の情報が広く集まる同展では、様々なチャンスが生まれ、新たな進化が起きることが期待できそうだ。



会場では最先端の技術や動向を把握できる企画展示のほか、各種講演等が開催される(写真：SEMI Japan)

より微弱な反射点も検出可能

分析装置

santec Japan (愛知県小牧市)

「SPA-110」は反射点計測、導波路伝搬損失計測、波長依存損失計測を提供するsantec波長可変レーザー(TSLシリーズ)のアドオンモジュール。測定距離を従来機の6倍以上の30m、損失測定ダイナミックレンジを80dBまで拡大した。



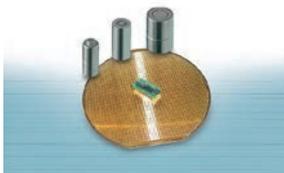
資料請求番号 12412-01501

非接触で厚さ測定が可能

静電容量式capaNCDT

Micro-Epsilon Japan (大阪府吹田市)

「DT6200シリーズ」は、表面粗さの影響を受けずにシリコンウェーハを挟み込み、サブミクロンの分解能で厚さを測定することが可能な高精度センサ。仮想接地機能により、ウェーハの接地なしで測定できる。



資料請求番号 12412-01502



Micro-Epsilon Japanは12/11～13開催の
セミコンジャパン2024に出展します(小間番号6921)
皆様のご来場をお待ちしております

MICRO-EPSILON社の変位センサは 様々な半導体製造装置で採用されています

- 静電容量式センサ UHV対応、-270～200℃、最大800℃まで使用可
(ウェハ厚さ測定、ウェハステージの位置制御、レンズアライメントなど)
- 共焦点センサ UHV対応、Φ4mm径センサあり
(ウェハ厚さ測定、ソーマークの検出、ボウ・ワーブの測定、マスクアライメントなど)
- 白色干渉計 UHV対応、Φ4mm径センサあり
(ウェハ厚さ測定、マスクアライメントなど)
- 渦電流センサ
(ワイヤソーのたわみ測定など)
- レーザー形状測定センサ
(搬送ウェハの位置制御など)
- その他、アプリケーションに適した様々なセンサを提案します!

デモ機用意していますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社製品の良さを体感いただけます。



MICRO-EPSILON Japan株式会社
www.micro-epsilon.jp | Email: info@micro-epsilon.jp

東京オフィス
〒101-0047
東京都千代田区内神田1-15-2
神田オーシャンビル2F
TEL: 03 (3518) 9868

大阪本社
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1丁目
23-43ファサード江坂ビル10F
TEL: 06 (6170) 5257

資料請求番号 12412-01503